

**关于深圳英集芯科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件  
第二轮审核问询函的专项核查意见**

---

**容诚专字[2021]518Z0510 号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

**关于深圳英集芯科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件  
第二轮审核问询函的专项核查意见**

容诚专字[2021]518Z0510 号

**上海证券交易所：**

根据贵所于 2021 年 9 月 8 日出具的上证科审（审核）〔2021〕558 号《关于深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。

**说明：**

1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）一致。涉及招股说明书补充披露或修改的内容已在招股说明书中以**楷体加粗**方式列示。

2、本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。

3、本回复中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

## 目 录

1、关于收入.....	4
2、关于毛利率.....	13
3、关于研发费用.....	17
4、关于存货.....	21
5、关于政府补助.....	29
7、关于其他.....	32
7.1 苏州智集芯 .....	32
7.2 定期存款 .....	36

## 1、关于收入

根据首轮问询回复：（1）报告期各期主营业务收入分别为 21,491.09 万元、33,768.60 万元、37,475.53 万元和 35,190.86 万元；（2）报告期各期海外地区收入分别为 235.45 万元、456.11 万元、322.75 万元和 1,164.59 万元，2021 年 1-6 月增长较快系小米、OPPO 等客户通过境外方式采购快充协议芯片金额大幅增长；（3）2021 年新增前五大客户东莞市众麦祥电子科技有限公司为 OPPO 供应链的主要经销商，2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月采购金额分别为 1.15 万元、1,326.72 万元和 2,639.91 万元，主要产品型号为 IP2161\_OP，销售毛利率分别为 19.18%、30.78%和 34.41%；根据公开资料，该公司参保人数仅 3 人；（4）公司 IP2161\_OP 等产品通过小米、OPPO 验证的时点与产生相应收入的时点间隔较短。

请发行人说明：（1）2021 年 1-6 月收入大幅上升的原因，与同行业可比公司收入增速的差异情况及原因；（2）小米、OPPO 等客户通过境外方式采购快充协议芯片金额大幅增长的原因及商业合理性；（3）OPPO 通过经销商众麦祥电子进行采购的原因，IP2161\_OP 产品 2020 年起毛利率大幅上升的原因；（4）公司产品通过小米、OPPO 验证的时点与产生相应收入的时点间隔较短的原因；（5）公司与经销商之间是否约定销售返利，若存在，说明返利的具体政策及相关会计处理。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

答复：

### 发行人说明事项

**（1）2021 年 1-6 月收入大幅上升的原因，与同行业可比公司收入增速的差异情况及原因**

#### 一、2021 年 1-6 月收入大幅上升的原因

报告期内，公司主营业务收入分产品类型的变动情况如下：

单位：万元

项目	细分类型	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	细分类型	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电源管理芯片	移动电源芯片	10,839.09	30.80%	16,789.96	44.80%	22,859.33	67.69%	16,677.21	77.60%
	车充芯片	3,435.80	9.76%	3,339.59	8.91%	2,308.48	6.84%	1,174.12	5.46%
	无线充电芯片	3,353.74	9.53%	3,581.63	9.56%	2,781.09	8.24%	334.38	1.56%
	TWS 耳机充电仓芯片	1,591.89	4.52%	1,317.13	3.51%	56.31	0.17%	0.00	0.00%
	其他	1,674.84	4.76%	1,794.51	4.79%	1,642.03	4.86%	1,257.23	5.85%
	小计	<b>20,895.36</b>	<b>59.38%</b>	<b>26,822.83</b>	<b>71.57%</b>	<b>29,647.24</b>	<b>87.80%</b>	<b>19,442.94</b>	<b>90.47%</b>
快充协议芯片	14,295.50	40.62%	10,652.70	28.43%	4,121.36	12.20%	2,048.15	9.53%	
合计	<b>35,190.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,475.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,768.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,491.09</b>	<b>100.00%</b>	

公司 2021 年 1-6 月收入增长较快，其中电源管理芯片方面，2021 年 1-6 月，公司实现收入 20,895.36 万元，占公司 2020 年全年电源管理芯片销售收入的比重高达 77.90%，显著提升；快充协议芯片方面，2021 年 1-6 月，公司实现收入 14,295.50 万元，超过 2020 年全年收入，收入大幅提升。产生上述情况的主要原因如下：

首先，近年来电源管理芯片及快充协议芯片市场的成长性得到充分释放，芯片行业整体向好。受中美贸易摩擦等因素影响，集成电路行业的国产替代趋势加快，许多国内半导体公司迎来新的发展机遇。尤其 2020 年下半年开始，大部分国内同行业芯片设计企业都处于收入大幅上升的快速发展阶段。

其次，公司快充协议芯片销售收入大幅增长，一方面系公司凭借在快充协议芯片领域的技术优势和研发积累，报告期内芯片产品进入小米、OPPO 等多家知名手机厂商原厂电源适配器的供应链，2021 年以来小米和 OPPO 采购发行人快充协议芯片数量大幅增长所致；另一方面系下游快充配件市场快速发展，公司产品适配多种快充协议，使得公司快充协议芯片销售数量增长所致。

最后，2021 年 1-6 月，随着疫情的缓解，休闲、商务活动恢复，导致出行增加带动了移动电源需求的增加，再加之消费者对移动电源芯片快充需求的提升，占电源管理芯片比重较高的移动电源芯片的收入上升。同时，随着公司产品线扩张和业务拓展，无线充电芯片、车充芯片及 TWS 耳机充电仓芯片收入持续增长。

综合以上因素，2021 年的 1-6 月公司的主营业务收入大幅上升。

## 二、英集芯与同行业可比公司收入增速的差异情况及原因

发行人与同行业可比公司收入增速对比情况如下：

单位：万元

同行业可比公司	2021 年 1-6 月主营业务收入	2021 年 1-6 月同比增长率	2020 年 1-6 月主营业务收入	2020 年 1-6 月同比增长率	2019 年 1-6 月主营业务收入
芯朋微	32,421.30	107.69%	15,610.29	7.34%	14,542.49
圣邦股份	91,546.45	96.66%	46,550.90	57.41%	29,572.80
上海贝岭	99,125.30	140.89%	41,149.33	12.18%	36,681.59
力芯微	36,924.73	64.86%	22,397.65	4.37%	21,460.27
晶丰明源	106,553.47	177.25%	38,431.79	-6.51%	41,109.33
发行人	35,190.86	250.67%	10,035.38	-16.64%	12,038.66

注：上述可比公司数据来自可比公司招股说明书及公告文件，上表中发行人 2019 年 1-6 月和 2020 年 1-6 月主营业务收入数据为未审数据。

由上表可知，2021 年 1-6 月，发行人与同行业可比公司的主营业务收入都处于快速增长状态，发行人的主营业务收入增速高于同行业可比公司。主要原因如下：

首先，发行人和同行业可比公司的具体产品、下游应用领域及业务开展情况有所不同，导致发行人与同行业可比公司的主营业务收入增速存在差异。从上表可知，由于疫情影响，2020 年上半年相比于 2019 年同期，发行人主营业务收入下降达 16.64%，与同行业可比公司存在差异。发行人的产品主要应用于移动电源、电源适配器等消费电子相关领域，该领域受疫情影响较大。而可比公司的产品则分散于家用电器、工业控制、LED 照明、智能电表等领域，其中，芯朋微的产品主要应用于家用电器等领域，圣邦股份的产品主要应用于包括家电在内的消费类电子及工业控制等领域，上海贝岭的产品主要应用于智能电表等领域，力芯微的产品主要应用于手机、可穿戴设备等领域，晶丰明源的产品主要应用于 LED 照明等领域。上述可比公司营业收入受疫情影响相对较小。由于发行人产品所处应用领域受疫情影响较大，2021 年以来，随着疫情的缓解，下游市场对发行人电源管理芯片等相关产品的需求回升，发行人主营业务收入增速较快。

其次，报告期内，手机等消费电子产品的快充功能得到普通消费者越来越多

的认可，同时小米、OPPO 等手机品牌厂商把快充功能逐步从旗舰机渗透到更多的手机机型，对快充协议芯片的需求提升。发行人的快充协议芯片产品适配多种快充协议，2020 年以来已经逐步供应小米、OPPO 手机的多个主流机型。2021 年 1-6 月，由于小米、OPPO 对于发行人快充协议芯片采购的增加，再加之快充配件市场快速发展带来的需求提升，发行人快充协议芯片销售收入实现大幅增长，主营业务收入增长较快。

最后，随着产品线的拓展，发行人无线充电芯片、车充芯片及 TWS 耳机充电仓芯片业务不断拓展，上述芯片产品营业收入大幅增加，主营业务收入快速增长。

综上所述，2021 年 1-6 月，发行人主营业务收入增速高于同行业可比公司具有合理性。

## (2) 小米、OPPO 等客户通过境外方式采购快充协议芯片金额大幅增长的原因及商业合理性

小米、OPPO 通过境外方式采购发行人快充协议芯片需要经过经销商、代工厂等环节。发行人的芯片产品通过小米、OPPO 验证进入其供应链后，小米、OPPO 的代工厂会根据生产需求向经销商下单采购，经销商从发行人处采购芯片产品销售给代工厂。从采购便利性及结算条件等自身角度考虑，部分代工厂会要求经销商选择作为全球消费电子产品重要集散地的香港交货。

小米、OPPO 通过境外方式采购快充协议芯片产品的情况如下：

单位：万元

最终品牌客户	经销商	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年	
		销售金额	占比	销售金额	占比	销售金额	占比
OPPO	益登科技股份有限公司	274.40	85.95%	5.80	100.00%	-	-
	其他	44.87	14.05%	-	-	-	-
	小计	319.28	100.00%	5.80	100.00%	-	-
小米	益登科技股份有限公司	487.39	79.73%	41.58	79.92%	-	-
	其他	123.93	20.27%	10.45	20.08%	116.52	100.00%
	小计	611.32	100.00%	52.02	100.00%	116.52	100.00%

境外采购快充协议芯片合计	930.60	-	57.82	-	116.52	-
占小米、OPPO 当期总体采购的比例	9.81%	-	0.74%	-	6.71%	-

由上表可知，2020 年以后，发行人主要通过经销商益登科技股份有限公司向境外销售小米、OPPO 所需的快充协议芯片。益登科技股份有限公司（TWSE:3048）是一家主要从事半导体零组件的研发、制造和销售业务的台湾主板上市公司。其分别将发行人的产品销售给小米及 OPPO 的代工厂商。其中小米的代工厂商出于自身使用外汇支付的结算条件考虑，要求在香港交货并以美元结算；OPPO 的代工厂由于需要向 OPPO 的印度工厂供应产品，出于对采购及结算便利性的考虑，故其要求所采购芯片在香港交货。综上，小米、OPPO 的代工厂通过境外方式采购发行人快充协议芯片具备商业合理性。

同时，根据上表可知，2021 年 1-6 月，小米、OPPO 通过境外方式采购发行人快充协议芯片金额为 930.60 万元，相比于 2020 年增幅较大，主要系随着小米、OPPO 对于发行人快充协议芯片总体需求的增加，对发行人的快充协议芯片的总体采购量增加且小米、OPPO 的部分代工厂选择由境外采购发行人的快充协议芯片所致。报告期内，小米、OPPO 通过境外方式采购快充协议芯片金额较小，占其总体采购比例较低。

### **(3) OPPO 通过经销商众麦祥电子进行采购的原因，IP2161\_OP 产品 2020 年起毛利率大幅上升的原因**

#### **一、OPPO 通过经销商众麦祥电子进行采购的原因**

发行人的芯片得到 OPPO 等最终品牌用户使用的过程中需要经过经销商、代工厂等环节。报告期内，OPPO 的代工厂通过经销商众麦祥电子采购发行人的芯片产品。

众麦祥电子的基本情况如下：

东莞市众麦祥电子科技有限公司	
经营范围	研发、销售：锂离子电池、集成电路、电子产品及配件、电子元器件、通讯产品、音视频设备；批发业、零售业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。



主营业务情况	消费电子类产品的经销
注册资本情况	500.00 万元人民币
股东情况	余萍持股 60.00%，黄强持股 40.00%
成立时间	2018 年 5 月
员工人数	15 人

注：众麦祥电子员工人数为 15 人，其中 4 人在众麦祥电子缴纳社保，其余员工由于涉及异地办公因此通过自行等方式缴纳社保。

根据众麦祥电子的确认，截至目前，其公司拥有员工人数 15 人，截至 2021 年 6 月底，众麦祥电子总资产已达到 3,000 万元以上。除向发行人采购产品外，众麦祥电子也同时采购其他消费电子企业的产品对外销售，2020 年以来其年营业收入规模维持在 6,000 万元以上，其中 2021 年上半年其营业收入约为 1.3 亿元。2018 年至 2021 年 1-6 月，众麦祥电子的毛利率水平与行业内其他经销商基本一致，不存在异常情形。此外，众麦祥电子与发行人及发行人员工不存在关联关系。

在发行人所处的集成电路设计行业，行业内公司一般采用经销模式对外销售，经销商承担行业内公司与各终端客户之间物流、资金、账期的协调及调配等职能。该职能的履行主要依赖于经销商的资金实力、团队的行业经验及销售渠道资源等多重因素，与人员规模的相关性相对较低。同时，行业内公司也存在其主要经销商人员较少，采购金额较多的情况。具体情况如下：

行业内公司	经销客户名称	客户情况	参保人数	经销商采购金额 (万元)
力芯微	无锡诚科电子有限公司	2020年第四大经销客户	5	540.08
	无锡和悦电子有限公司	2020年第五大经销客户	5	468.34
芯朋微	南京联达芯电子科技有限公司	2019年第二大经销客户	8	2,572.84
	中山市德创电子科技有限公司	2019年第四大经销客户	9	1,519.85
	常州市宝丽光电有限公司	2019年第五大经销客户	4	1,507.99
	深圳市仁荣电子有限公司	2018年第二大经销客户	9	2,519.12
晶丰明源	广州晶丰电子科技有限公司	2019年1-6月第一大经销客户	6	5,488.21
	上海迎霄电子有限公司	2017年第三大经销客户	8	5,077.11

注：上述行业内公司经销商相关采购金额数据来自行业内公司招股说明书，其参保人数来自第三方网站查询。

众麦祥电子的业务团队拥有多年的消费电子行业经验，通过自身经营积累了一定的资金资源和建立了相应的供应渠道，了解客户生产订货需求，可以为客户提前备货、协调调配、满足客户的信用期要求。同时除 OPPO 外，众麦祥电子主要服务于小天才、步步高等在内的步步高体系最终品牌客户，对于步步高体系内的公司生产及供应链流程相对熟悉，能够提高 OPPO 及其代工厂的供应链运营效率。因此，OPPO 的代工厂通过众麦祥电子采购发行人的芯片产品。

## 二、IP2161\_OP 产品 2020 年起毛利率大幅上升的原因

报告期内，公司销售给众麦祥电子的 IP2161\_OP 产品的单价和成本情况已经申请豁免信息披露。其销售数量及毛利率情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年	2019年
销售数量（万颗）	1,877.54	4,225.32	3.80
毛利率	34.41%	30.78%	19.18%

报告期内，发行人向众麦祥电子销售的 IP2161\_OP 的价格未发生变化，2020 年毛利率上升主要系 2019 年产品推出时间较短，封测数量较少，未形成规模导致封测单位成本较高，2020 年封测数量增加，封测成本下降，造成毛利率上升所致。2021 年 1-6 月毛利率上升主要系受人民币升值影响，IP2161\_OP 对应的原材料成本下降所致。

### （4）公司产品通过小米、OPPO 验证的时点与产生相应收入的时点间隔较短的原因

公司产品通过小米、OPPO 验证的时点与产生相应收入的时点情况如下：

序号	终端品牌名称	产品型号	产品开始验证时点	产品通过验证时点	产生相应收入时点	产生相应收入时点的销售数量（颗）	产业化时点	产品通过验证至产业化时间间隔
1	小米	IP2718	2019/3/27	2019/7/18	2019/7/22	1,000	2019/10/29	3 个月 11 天
2	小米	IP2729	2019/7/3	2019/10/11	2019/10/21	600	2020/3/18	5 个月 7 天
3	OPPO	IP2196T	2019/7/4	2019/12/18	2019/12/20	1,000	2020/10/23	10 个月 5 天
4	OPPO	IP2197	2019/12/20	2020/9/9	2020/9/18	2,500	2021/1/11	4 个月 2 天
5	OPPO	IP2161_OP	2019/8/30	2019/11/27	2019/11/28	3,000	2020/2/24	2 个月 28 天

注：公司通常将芯片产品出货量达到 100 万颗的时点视为该产品的产业化时点。

公司产品通过最终品牌客户认证后，最终品牌客户会较快下单，安排代工厂

进行小批量生产,小批量生产阶段最终品牌客户的采购规模通常在 500 颗至 3000 颗左右。除小米、OPPO 外,公司产品通过公牛、三星验证后,公牛、三星也会尽快下单采购安排代工厂进行小批量生产。在此阶段,公司会较快产生相应的收入。因此,公司产品通过小米、OPPO 验证的时点与产生相应收入的时点间隔较短,具备合理性。公司产品通过小米、OPPO 等最终品牌客户验证之后,最终品牌客户会根据小批量生产阶段的相关产品生产情况、市场需求情况向产业化生产阶段过渡,增加对发行人芯片的采购量。相比于产生相应收入的时点,公司产品通过小米、OPPO 验证后的产业化时点更有具有阶段性参考意义。由上表可知,发行人产品通过小米、OPPO 验证的时点与产业化时点的时间间隔一般在 3 个月至 12 个月左右。其中最终品牌客户 OPPO 对应的 IP2161\_OP 芯片产品通过验证时点与产业化时点之间的时间间隔略小于 3 个月。由于该型号产品为发行人功率为 18w 的芯片产品,OPPO 对于 18w 充电器产品的需求量增加较快,同时,发行人该类型产品的生产技术较为成熟,且发行人为 OPPO 该类型芯片产品的主要供应商。因此,该类型芯片产品通过验证后,OPPO 对发行人芯片的需求较紧急,较快推进产品产业化生产,较快向发行人大规模采购,从而使得该类型产品通过验证时点与产业化时点之间的时间间隔略小于 3 个月。

#### **(5) 公司与经销商之间是否约定销售返利,若存在,说明返利的具体政策及相关会计处理**

报告期内,发行人主要通过经销模式进行销售,发行人与经销商协商确定销售价格,签订框架合同和具体订单,并不存在约定产品销售返利的情形,不涉及返利的具体政策及相关会计处理事项。

### **申报会计师核查事项**

#### **(1) 核查程序**

1、获取发行人分产品的主营业务收入明细表,结合收入类别分析报告期内变动原因;向发行人销售部门人员了解发行人主营业务增长情况及影响因素;查阅同行业可比公司招股说明书、年度报告、半年度报告等公开资料,对比分析发行人与同行业可比公司收入增速的差异情况及原因;

2、向发行人销售部门人员了解小米、OPPO 等客户相关的境外采购情况、

原因及合理性；

3、取得公司境外销售明细表，分析小米、OPPO 等客户通过境外方式采购快充协议芯片金额增长的原因；

4、获取东莞市众麦祥电子科技有限公司确认的经营情况表和说明函，结合对于东莞市众麦祥电子科技有限公司的访谈记录，分析 OPPO 通过经销商众麦祥电子进行采购的原因；

5、查询同行业可比公司招股书、年度报告、半年报等公开资料，结合企查查等第三方网站，检索同行业可比公司的经销商是否存在人数较低但采购金额较高的情况；

6、取得东莞市众麦祥电子科技有限公司提供的其与 OPPO 及其代工厂的订单计划邮件，确认发行人通过东莞市众麦祥电子科技有限公司向 OPPO 销售芯片产品的真实性；

7、获取东莞市众麦祥电子科技有限公司及发行人出具的说明函，交叉比对发行人员工名册与众麦祥电子股东，确认众麦祥电子与发行人及发行人员工不存在关联关系；获取东莞市众麦祥电子科技有限公司关于其自身毛利率情况以及其与行业内其他经销商毛利率平均水平对比情况的说明，确认不存在异常情形；

8、获取型号为 IP2161\_OP 的芯片产品收入成本表，结合单价及成本的报告期内变动情况，分析其毛利率变动原因；

9、结合发行人相关销售制度、对经销商的访谈情况以及发行人相关产品的销售合同及订单，了解公司与经销商之间是否存在销售返利情形。

## **(2) 核查结论**

经核查，申报会计师认为：

1、公司 2021 年 1-6 月销售收入大幅上升主要受行业整体向好、疫情缓解、发行人最终品牌客户开拓以及自身产品线扩展等多因素的影响；发行人 2021 年 1-6 月收入增速高于同行业可比公司主要系由于发行人及同行业可比公司所处细分领域不同、受疫情的影响程度不同，且发行人自身业务开拓原因所致，具有合理性；

2、小米、OPPO 通过境外方式采购快充协议芯片金额大幅增长，主要系随着小米、OPPO 对于发行人快充协议芯片总体需求的增加，对发行人的快充协议芯片的总体采购量增加且小米、OPPO 的部分代工厂选择由境外采购发行人的快充协议芯片所致，具备商业合理性；

3、众麦祥电子作为经销商拥有经验较丰富的业务团队，积累了一定的资金资源及相应渠道，能够为 OPPO 代工厂提前备货、协调调配、满足客户的信用期要求，且其主要服务于包括小天才、步步高等在内的步步高体系最终品牌客户，对于步步高体系内的公司生产及供应链流程相对熟悉，因此 OPPO 代工厂通过众麦祥电子向发行人进行采购；

4、IP2161\_OP 产品 2020 年毛利率上升主要系 2019 年产品推出时间较短，封装量较少，未形成规模导致封测单位成本较高，2020 年封测数量增加，封测成本下降，造成毛利率上升所致；2021 年 1-6 月毛利率上升主要系人民币升值，IP2161\_OP 对应的原材料成本有所下降所致；

5、公司产品通过最终品牌客户认证后，最终品牌客户会较快下单采购，安排代工厂进行小批量生产，发行人会较快产生相应收入。上述情形普遍存在于公司与最终品牌客户公牛、三星、小米、OPPO 的合作过程中。相比于产生相应收入的时点，公司产品通过小米、OPPO 验证后的产业化时点更有具有阶段性参考意义。公司产品通过小米、OPPO 验证后至产业化时点的时间间隔基本在 3 个月以上，少数不足 3 个月的情形为最终品牌客户需求较紧急，较快进行大规模采购所致。因此，公司产品通过小米、OPPO 验证的时点与产生相应收入的时点间隔较短，具备合理性；

6、报告期内，发行人与经销商之间不存在约定销售返利的情形，不涉及返利的具体政策及相关会计处理事项。

## 2、关于毛利率

根据首轮问询回复：（1）2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月低功率无线充电芯片毛利率分别为 20.88%、21.52%和 30.79%；（2）报告期各期单口输出车充芯片毛利率分别为 47.33%、40.44%、34.60%和 39.23%；双口输出车充芯片毛利率分别为 41.93%、35.32%、29.72%和 34.07%。

请发行人说明：（1）2021年1-6月低功率无线充电芯片毛利率大幅上升的原因；（2）单口输出车充芯片毛利率高于双口输出芯片毛利率的原因。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

答复：

### 发行人说明事项

#### **（1）2021年1-6月低功率无线充电芯片毛利率大幅上升的原因；**

报告期内，发行人无线充电芯片按功率区分的单价、单位成本情况已经申请豁免信息披露，其毛利率情况如下：

功率	项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
低	毛利率	30.79%	21.52%	20.88%	-
中	毛利率	44.78%	41.38%	50.24%	-
高	毛利率	50.18%	48.29%	52.82%	52.00%

2019年度，发行人开始推出低功率无线充电芯片产品，并于2020年度快速导入市场，低功率无线充电芯片产品毛利率在2019年度及2020年度较为稳定。2021年1-6月，发行人不同功率无线充电芯片毛利率较2020年均有所上涨，系下游需求旺盛，产品供不应求，公司提高平均单价，再加之受人民币升值等因素的影响，平均成本下降所致。

发行人低功率无线充芯片毛利率增长高于中、高功率无线充电芯片，系由于：  
1、单价方面：低、中、高功率无线充电芯片2021年1-6月单价较2020年增长分别为5.40%、3.63%和1.34%，其中低功率无线充电芯片因为初始定价较低且发行人分配产能较少，相对供不应求，故单价涨幅最大；  
2、单位成本方面：低、中、高功率无线充电芯片2021年1-6月单位成本较2020年下降分别为7.05%、2.38%和2.36%，低功率无线充电芯片成本下降幅度最大是因为除了人民币升值导致的原材料成本下降外，在2020年下半年以后，发行人逐渐把低功率无线充电芯片的封装采购转到封装单价较低的工厂，其封装成本下降所致。

#### **（2）单口输出车充芯片毛利率高于双口输出芯片毛利率的原因。**

报告期内，发行人单口输出车充芯片和双口输出车充芯片按照充电效率区分

的收入、毛利率情况如下：

单/双口	充电效率	2021年1-6月			2020年			2019年			2018年		
		收入 (万元)	收入 占比	毛利率	收入 (万元)	收入 占比	毛利率	收入 (万元)	收入 占比	毛利率	收入 (万元)	收入 占比	毛利率
单口	快充	2,069.17	84.56%	-	2,120.39	78.72%	-	1,332.22	75.16%	-	933.20	84.00%	-
	慢充	377.73	15.44%	-	573.09	21.28%	-	440.27	24.84%	-	177.81	16.00%	-
	小计	<b>2,446.90</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>2,693.48</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>1,772.50</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>1,111.01</b>	<b>100.00%</b>	-
双口	快充	667.54	67.50%	-	354.44	54.86%	-	239.27	44.64%	-	35.98	57.01%	-
	慢充	321.36	32.50%	-	291.67	45.14%	-	296.72	55.36%	-	27.13	42.99%	-
	小计	<b>988.90</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>646.12</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>535.98</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>63.12</b>	<b>100.00%</b>	-

注：上表中毛利率情况已经申请豁免信息披露。

单口输出车充芯片毛利率高于双口输出车充芯片毛利率主要系毛利率较高的快充芯片在单口输出车充芯片收入中占比更高，且双口输出车充芯片中的慢充芯片毛利率低于单口输出车充芯片中慢充芯片毛利率所致。

单口输出车充芯片中毛利率较高的快充芯片收入占比在报告期内分别为 84.00%、75.16%、78.72%和 84.56%，而双口输出车充芯片中毛利率较高的快充芯片收入占比较低，在报告期内分别为 57.01%、44.64%、54.86%和 67.50%。同时，由于双口输出车充芯片中慢充芯片（IP6515）进入市场的时间相对较晚，为了快速抢占市场，公司对该类型芯片采取了价格较低的定价策略，使得双口输出车充芯片中慢充芯片的毛利率显著低于单口输出车充芯片中慢充芯片的毛利率。且双口输出车充芯片中慢充芯片（IP6515）的销售收入占比较高，进而拉低了双口输出车充芯片整体毛利率。剔除慢充芯片（IP6515）的影响后，双口输出车充芯片报告期内毛利率高于报告期内单口输出车充芯片的毛利率。



## 申报会计师核查事项

### (1) 核查程序

1、获取不同产品的主营业务成本数据，分析比较报告期各期产品成本结构及其变动情况；向研发部门人员了解影响芯片成本变动的具体因素，并了解公司具体型号产品对应晶圆、封测成本等情况；

2、获取低功率无线充电芯片、车充芯片等不同类型芯片的毛利率数据并分析毛利率变动原因；

3、向采购部门人员了解影响低功率无线充电芯片、车充芯片成本变动的具体因素，并了解公司具体型号产品对应晶圆、封测成本等情况；

4、向销售部门人员了解影响低功率无线充电芯片、车充芯片价格变动的具体因素，并了解公司具体型号产品的市场需求、销售策略等情况。

### (2) 核查结论

经核查，申报会计师认为：

1、2021年1-6月低功率无线充电芯片毛利率大幅上升是由于其销售价格因初始定价较低且产品供不应求而上升，同时该类产品的原材料成本及封测成本下降所致，具备合理性；

2、单口输出车充芯片毛利率高于双口输出芯片毛利率是由于不同类型芯片内部结构不同及细分类型芯片毛利率差异造成，具备合理性。

## 3、关于研发费用

根据首轮问询回复：（1）报告期各期掩膜版费用分别为864.88万元、782.79万元、641.87万元和534.64万元，2019年、2020年公司掩膜版费用降低系晶圆厂为鼓励公司流片给予了掩膜版返利；（2）公司将光罩在购买时一次性计入研发费用科目核算。

请发行人说明：（1）晶圆厂给予掩膜版返利的具体情况，与掩膜版返利相关的会计政策及财务影响；（2）2021年1-6月掩膜版费用大幅上升的原因；（3）结合光罩在研发、生产活动中的使用情况说明光罩在购买时一次性计入研发费用的会计核算是否合理。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

答复：

### 发行人说明事项

**(1) 晶圆厂给予掩膜版返利的具体情况，与掩膜版返利相关的会计政策及财务影响；**

报告期内，晶圆厂台积电为鼓励公司投片，给予了公司掩膜版返利优惠，具体返利政策为：2018年及2019年度，当公司购买相关制程规格的掩膜版每达到三套时，则可在正常价格之外给予该三套掩膜版15%价格返利优惠，即以每三套掩膜版为一个返利优惠考核单元；2020年度，当公司购买相关制程规格的掩膜版每达到三套时，则可在正常价格之外给予该三套掩膜版12.5%价格返利优惠；2021年度，因全球芯片缺货，晶圆厂产能供不应求，台积电未给予公司掩膜版投片返利政策优惠。因返利协议同时约定，台积电保留有权在任何时候以任何理由撤销或修改向客户提供的任何折扣。基于谨慎性原则，公司在满足台积电约定的掩膜版返利条件，经向台积电提出返利申请并由其审批确认后，即在财务上确认掩膜版返利金额，相应冲减当期研发费用-掩膜版费。

2019年度，格罗方德出于经营考虑，出售了其位于新加坡的一家代工厂，公司需进行转厂生产并根据新工厂制造工艺重新制作掩膜版。格罗方德为鼓励公司继续合作，对其中10款型号转厂晶圆约定了掩膜版返利条款，即对该10款晶圆若在转厂后1.5年内单个型号晶圆采购量达到1500片时，格罗方德则返还该型号晶圆公司因转厂所发生的掩膜版费用，若未达到该标准则由公司自行承担掩膜版制版费用。格罗方德与公司约定的上述掩膜版返利政策中的4款晶圆型号采购量于2020年度达到了上述返利条件并在当期给予了公司返利优惠，其余6款晶圆型号因转厂后1.5年内采购量未达到返利政策要求，故公司未能获取到相关掩膜版返利优惠。公司于2020年度收到格罗方德给予的掩膜版返利并一次性确认。如果按享受掩膜版返利的晶圆型号各期采购量进行分期确认，则2019年度、2020年度应分别确认掩膜版返利金额为14.19万元、77.08万元，但考虑到公司与格罗方德的掩膜版返利，系因格罗方德转厂而产生，返利与后续的晶圆采购量相关，存在较大的不确定性。公司基于谨慎性原则，在达到掩膜版返利条件当期提出申请，在收到返利当年即在财务上一次性确认掩膜版返利金额，相应冲减当期研发费用-掩膜版费，上述会计处理符合准则规定，同时跨期金额14.19万元对财务数据整体影

响较小，因此公司关于掩膜版返利的会计处理是恰当的。

报告期各期，格罗方德和台积电给予公司的掩膜版返利金额具体如下：

单位：万元

晶圆厂	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
台积电	0.00	44.19	36.67	52.13
格罗方德	0.00	91.27	0.00	0.00
合计	<b>0.00</b>	<b>135.47</b>	<b>36.67</b>	<b>52.13</b>
当期利润总额	4,661.92	6,820.69	2,075.03	2,883.51
占比	0.00%	1.99%	1.77%	1.81%

报告期各期，晶圆厂给予公司的掩膜版返利金额分别为 52.13 万元、36.67 万元、135.47 万元和 0.00 万元，上述返利金额直接冲减了返利当期研发费用。各期掩膜版返利占利润总额的比例分别为 1.81%、1.77%、1.99%和 0.00%，对公司财务状况整体影响较小。

## (2) 2021 年 1-6 月掩膜版费用大幅上升的原因；

报告期内，公司研发费用中的掩膜版费用包括新增研发项目制版、项目改版升级和转厂重制掩膜版，各期因不同类型发生的掩膜版费用具体如下：

单位：套，万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
新增研发项目制版	12.00	358.32	16.00	495.75	10.00	368.00	17.00	572.87
项目改版升级	17.00	143.71	27.00	270.38	24.00	229.02	36.00	344.13
转厂重新制版	1.00	32.61	1.00	11.21	9.00	222.44	-	-
掩膜版返利		-		-135.47		-36.67		-52.13
合计	<b>30.00</b>	<b>534.64</b>	<b>44.00</b>	<b>641.87</b>	<b>43.00</b>	<b>782.79</b>	<b>53.00</b>	<b>864.88</b>

注：部分项目改版升级与转厂同时进行，为避免重复计算，上表统一归类至项目改版升级中。

掩膜版费用发生于研发过程中的制版环节。其中，项目改版升级系产品在具体应用过程为不断响应市场客户需求而进行的部分功能升级改造，与下游市场需求变化相关。

2021年1-6月掩膜版费用上升较多主要是随着公司规模扩张，研发投入加大，本期新增研发项目制版较多，相应的新增研发项目制版费用有所增加；同时，公司本期尚未得到晶圆厂给予的掩膜版返利优惠，综合导致2021年1-6月掩膜版费用相对前期有所上升。

**(3) 结合光罩在研发、生产活动中的使用情况说明光罩在购买时一次性计入研发费用的会计核算是否合理。**

光罩系晶圆制造过程中使用的图形模板，同一晶圆型号产品只会制作一套光罩，后续产品生产都需通过该光罩完成。光罩为公司产品研发的必要环节，公司产品在完成电路设计、版图设计、版图验证等IC设计流程后，则委托掩膜版制造厂商进行光罩制版，制版完成后再进行工程批流片。光罩所生产的研发样片在经测试评审及客户验证合格之前，无法判定其是否能够使用；即使当光罩生产的样片经检测合格可投入使用时，亦无法准确估计光罩的实际使用周期，因此结合企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，公司将报告期内发生的光罩费用于制版完成购买时一次性计入研发费用。

查询同行业可比公司、近期正在接受或通过交易所审核的芯片设计公司，将光罩费用一次性计入研发费用的情况如下：

公司名称	关于光罩的会计核算方法
晶丰明源	计入研发费用
芯朋微	计入研发费用
力芯微	计入研发费用
必易微	计入研发费用
艾为电子	计入研发费用
炬芯科技	计入研发费用

故公司关于光罩在购买时一次性计入研发费用的会计核算符合同行业公司处理惯例。

### **申报会计师核查事项**

#### **(1) 核查程序**

- 1、访谈发行人财务总监，了解报告期内研发项目的投入情况、掩膜版返利条件及各期返利金额、掩膜版在生产及研发过程中的使用情况等；
- 2、获取报告期各期掩膜版返利政策相关文件、研发项目投入明细，检查分析各期

掩膜版返利金额入账是否准确、掩膜版费用变动原因等；

3、查询同行业可比公司关于光罩的会计处理并结合企业会计准则，判断公司关于光罩的会计处理是否合理。

## **(2) 核查结论**

经核查，申报会计师认为：

报告期各期，发行人关于晶圆厂给予的掩膜版返利会计处理准确，各期掩膜版返利金额对公司财务状况整体影响较小；2021年1-6月掩膜版费用上升较多主要系当期新增研发项目制版费用较多所致；发行人关于光罩在购买时一次性计入研发费用的会计核算合理，符合企业会计准则规定和行业处理惯例。

## **4、关于存货**

根据首轮问询回复：（1）2019年公司对库龄1年以内产成品计提较多存货跌价准备的原因是三星快充协议升级，对应用于三星快充协议产品IP2160、IP2161计提存货跌价准备。应对上述风险，公司在产品设计时增加了二次烧录功能；（2）2021年6月末存货跌价准备下降原因之一系核销了已无使用价值而前期已计提存货跌价准备的存货487.04万元。

请发行人说明：（1）截至目前存货中是否存在其他不支持二次烧录的产品，结合不同芯片的迭代周期及影响因素、存货库龄情况等进一步说明存货跌价准备计提的充分性；（2）2021年6月末核销的存货情况及原因。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

答复：

### **发行人说明事项**

（1）截至目前存货中是否存在其他不支持二次烧录的产品，结合不同芯片的迭代周期及影响因素、存货库龄情况等进一步说明存货跌价准备计提的充分性；

一、截至目前存货中是否存在其他不支持二次烧录的产品

报告期内，公司产品主要为电源管理芯片和快充协议芯片。

（一）电源管理芯片

对于电源管理芯片而言，应用领域非常广泛，一般生命周期相对较长，通常无升级更新需求。

## （二）快充协议芯片

部分快充协议芯片，可能存在芯片产品在烧录程序后至销售完成前因快充技术升级进而需要升级芯片参数即进行二次烧录更新的情形。

2019年快充协议芯片产品IP2160、IP2161计提了较多存货跌价准备，一是该芯片为公司开发的第一代快充协议芯片，在芯片设计阶段未充分考虑到可能因快充技术升级而重新烧录程序的需求，故设计的芯片仅可进行程序一次烧录成型而不含有二次烧录程序功能；二是公司前期为快速抢占下游客户，根据市场预测提前将该类芯片进行了较多备货，因该批芯片当时已完成程序烧录而无法更新到最新程序，故导致单项计提了较多存货跌价准备。公司后续不断加深对下游客户需求的了解，生产过程中会根据市场需求烧录相应程序；同时，自2019年2月开始在新一代芯片设计时增加了再次升级烧录功能，可有效避免出现无法升级更新的风险。

截至2021年6月30日，公司存货按是否可能存在升级更新需求及是否支持二次烧录功能的具体明细如下：

单位：万元

项目		1年以内		1-2年		2年以上		合计	
		账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备
无升级更新需求		8,818.79	219.20	675.81	344.39	612.53	612.53	10,107.13	1,176.13
可能存在升级更新	支持二次烧录功能	3,664.55	50.41	59.85	5.28	5.12	5.12	3,729.52	60.81
	不支持二次烧录功能	583.24	0.53	21.70	21.70	60.29	60.29	665.23	82.53

截至2021年6月30日，公司存货中包含部分可能存在升级更新需求且暂不支持二次烧录功能的产品，一方面原因为随着公司经营规模扩大，对下游市场的判断力、掌控力都不断增强，自2020年开始公司根据下游订单安排芯片生产，不会仅根据市场需求预测而进行芯片备货，公司在进行程序烧录前，亦会根据订单和客户需求进行烧录，可有效避免出现烧录程序后不能销售的情形，截至目前公司并未发生因芯片不支持二次烧录而

无法销售的情形；此外若该类芯片增加二次烧录功能则需重新设计芯片，并经过制版、工程批流片验证等流程，会一定程度增加研发资源投入。综合考虑该类风险整体可控，公司未将可能存在升级更新需求的芯片全部升级为可支持二次烧录功能的芯片。

由上表可以看出，可能存在升级更新需求的存货中，约有84.86%的比例支持二次烧录功能，占比较大；少部分不支持二次烧录功能的芯片仅在程序烧录完成至出售前存在一定的风险，风险受芯片备货金额大小以及存货周转快慢影响。截至2021年6月30日，公司存货中可能存在升级更新需求且暂不支持二次烧录功能的存货余额为665.23万元，其中库龄1年以内的存货余额为583.24万元，占比87.67%；库龄超过1年的存货余额为81.99万元并已全额计提存货跌价准备。2021年1-6月可能存在升级更新需求且暂不支持二次烧录功能产品的销售收入为2,137.13万元，相对上年同期该类产品销售收入840.23万元有所上升，销售情况较好；本期该类存货从烧录完成至实现销售平均周转天数约22天，周转速度较快。整体而言，由于不支持二次烧录功能芯片带来的存货跌价风险可控。

## 二、结合不同芯片的迭代周期及影响因素、存货库龄情况等进一步说明存货跌价准备计提的充分性

报告期内，公司主要产品为电源管理芯片和快充协议芯片，电源管理芯片可实现电压电流转换功能，应用于移动电源、车充、TWS 耳机充电仓和无线充电等消费电子领域；快充协议芯片主要用于快充电源和快充设备之间充电电压和充电电流的控制，公司的快充协议芯片可支持 Apple、高通、联发科、华为、展讯、OPPO 等品牌的多种快充协议。客户采购发行人芯片生产的电子产品，通常都会通过 3C 数码认证或 FCC/CE 等全球认证，芯片作为电子产品的关键器件，在认证通过之后，一般不能轻易更换。公司芯片产品的生命周期一般为 2-5 年，如发行人 2018 年开发的产品，在 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月实现收入分别为 2,950.93 万元、13,004.87 万元、11,081.32 万元和 7,820.24 万元；2019 年开发的产品，在 2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月实现收入分别为 2,007.99 万元、12,675.51 万元和 14,661.94 万元，整体呈现上升趋势，生命周期相对较长。具体迭代周期受下游市场需求变化及行业同类竞品竞争因素影响而有所差异。

报告期各期末，公司存货按芯片应用领域及库龄结构计提的存货跌价准备明细如下：

单位：万元

2021年6月30日													
项目		1年以内			1-2年			2年以上			合计		
应用领域	存货类型	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例
电源管理芯片	原材料	2,563.59	31.88	1.24%	453.92	122.50	26.99%	107.49	107.49	100.00%	3,124.99	261.87	8.38%
	委托加工物资	3,234.10	-	-	-	-	-	-	-	-	3,234.10	-	-
	半成品	2,059.05	159.33	7.74%	96.40	96.40	100.00%	227.19	227.19	100.00%	2,382.64	482.91	20.27%
	产成品	861.45	23.94	2.78%	120.46	120.46	100.00%	260.89	260.89	100.00%	1,242.80	405.29	32.61%
	小计	8,718.19	215.15	2.47%	670.77	339.36	50.59%	595.56	595.56	100.00%	9,984.53	1,150.07	11.52%
快充协议芯片	原材料	1,151.59	-	-	54.57	-	-	-	-	-	1,206.16	-	-
	委托加工物资	820.50	-	-	-	-	-	-	-	-	820.50	-	-
	半成品	1,190.50	12.09	1.02%	2.33	2.33	100.00%	9.75	9.75	100.00%	1,202.57	24.16	2.01%
	产成品	1,108.51	41.69	3.76%	27.72	27.72	100.00%	71.32	71.32	100.00%	1,207.54	140.73	11.65%
	小计	4,271.09	53.78	1.26%	84.61	30.05	35.51%	81.06	81.06	100.00%	4,436.77	164.89	3.72%
其他	原材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	产成品	77.29	1.22	1.57%	1.98	1.98	100.00%	1.31	1.31	100.00%	80.57	4.50	5.59%
	小计	77.29	1.22	1.57%	1.98	1.98	100.00%	1.31	1.31	100.00%	80.57	4.50	5.59%
2020年12月31日													
项目		1年以内			1-2年			2年以上			合计		
应用领	存货类型	账面余额	存货跌价	计提比例	账面余额	存货跌价	计提比例	账面余额	存货跌价	计提比例	账面余额	存货跌价	计提比例



域			准备			准备			准备			准备	
电源管理芯片	原材料	5,454.93	46.40	0.85%	800.76	243.90	30.46%	-	-	-	6,255.69	290.30	4.64%
	委托加工物资	3,074.27	-	-	-	-	-	-	-	-	3,074.27	-	-
	半成品	1,218.61	205.82	16.89%	237.41	237.41	100.00%	307.26	307.26	100.00%	1,763.29	750.49	42.56%
	产成品	690.82	70.33	10.18%	301.03	301.03	100.00%	331.14	331.14	100.00%	1,322.99	702.50	53.10%
	小计	10,438.62	322.55	3.09%	1,339.20	782.34	58.42%	638.40	638.40	100.00%	12,416.23	1,743.29	14.04%
快充协议芯片	原材料	710.90	-	-	17.44	9.21	52.80%	-	-	-	728.34	9.21	1.26%
	委托加工物资	1,719.47	-	-	-	-	-	-	-	-	1,719.47	-	-
	半成品	382.55	0.11	0.03%	12.27	12.27	100.00%	3.82	3.82	100.00%	398.64	16.20	4.06%
	产成品	492.06	57.98	11.78%	111.91	111.91	100.00%	52.91	52.91	100.00%	656.88	222.80	33.92%
	小计	3,304.98	58.09	1.76%	141.62	133.39	94.19%	56.73	56.73	100.00%	3,503.34	248.21	7.08%
其他	原材料	5.18	-	-	-	-	-	-	-	-	5.18	-	-
	产成品	21.47	-	-	4.27	4.27	100.00%	0.25	0.25	100.00%	25.99	4.52	17.40%
	小计	26.65	-	-	4.27	4.27	100.00%	0.25	0.25	100.00%	31.17	4.52	14.51%
<b>2019年12月31日</b>													
项目		1年以内			1-2年			2年以上			合计		
应用领域	存货类型	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例
电源管理芯片	原材料	4,392.02	39.84	0.91%	215.89	157.87	73.12%	-	-	-	4,607.92	197.71	4.29%
	委托加工物资	885.98	-	-	-	-	-	-	-	-	885.98	-	-
	半成品	2,828.08	174.42	6.17%	150.70	150.70	100.00%	198.63	198.63	100.00%	3,177.41	523.76	16.48%
	产成品	1,667.40	105.33	6.32%	427.60	427.60	100.00%	48.12	48.12	100.00%	2,143.12	581.04	27.11%

	小计	9,773.49	319.59	3.27%	794.20	736.17	92.69%	246.75	246.75	100.00%	10,814.43	1,302.51	12.04%
快充协议芯片	原材料	471.81	-	-	19.55	-	-	0.27	0.27	100.00%	491.63	0.27	0.06%
	委托加工物资	264.45	-	-	0.68	0.68	100.00%	-	-	-	265.12	0.68	0.26%
	半成品	153.43	5.98	3.90%	3.95	3.95	100.00%	0.20	0.20	100.00%	157.58	10.13	6.43%
	产成品	292.43	141.90	48.53%	37.47	37.47	100.00%	0.04	0.04	100.00%	329.94	179.41	54.38%
	小计	1,182.12	147.89	12.51%	61.65	42.09	68.28%	0.51	0.51	100.00%	1,244.27	190.49	15.31%
其他	原材料	11.90	-	-	-	-	-	-	-	-	11.90	-	-
	产成品	88.52	-	-	0.26	0.26	100.00%	-	-	-	88.78	0.26	0.29%
	小计	100.42	-	-	0.26	0.26	100.00%	-	-	-	100.68	0.26	0.26%
<b>2018年12月31日</b>													
项目		1年以内			1-2年			2年以上			合计		
应用领域	存货类型	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面余额	存货跌价准备	计提比例
电源管理芯片	原材料	647.77	169.44	26.16%	176.89	50.61	28.61%	1.93	1.93	100.00%	826.60	221.98	26.85%
	委托加工物资	509.20	-	-	-	-	-	-	-	-	509.20	-	-
	半成品	1,581.80	16.96	1.07%	292.46	292.46	100.00%	6.18	6.18	100.00%	1,880.45	315.60	16.78%
	产成品	1,429.30	132.73	9.29%	40.24	40.24	100.00%	13.01	13.01	100.00%	1,482.54	185.97	12.54%
	小计	4,168.07	319.12	7.66%	509.59	383.32	75.22%	21.12	21.12	100.00%	4,698.79	723.56	15.40%
快充协议芯片	原材料	196.30	-	-	1.35	0.20	14.57%	-	-	-	197.66	0.20	0.10%
	委托加工物资	6.96	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96	-	-
	半成品	124.28	-	-	1.98	1.98	100.00%	-	-	-	126.26	1.98	1.57%
	产成品	459.29	1.72	0.37%	0.07	0.07	100.00%	-	-	-	459.36	1.79	0.39%

	小计	786.84	1.72	0.22%	3.40	2.25	66.03%	-	-	-	790.24	3.96	0.50%
其他	原材料	2.29	-	-			-	-	-	-	2.29	-	-
	产成品	58.59	-	-			-	-	-	-	58.59	-	-
	小计	60.88	-	-			-	-	-	-	60.88	-	-

注：其他中的原材料主要为包装耗材，产成品为贸易类MOS管。

报告期各期末，公司存货中电源管理芯片结构占比分别为84.66%、88.94%、77.84%和68.85%，整体占比呈现下降趋势；而快充协议芯片各期末存货结构占比分别为14.24%、10.23%、21.96%和30.59%，整体呈上升趋势，原因系随着快充协议芯片技术的成熟，下游应用领域快速增长。

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为13.11%、12.28%、12.51%和9.10%。2021年6月30日的存货计提比例下降，主要系：1）2021年1-6月公司加强呆滞存货的清理，核销了已无使用价值、无法实现销售的存货487.04万元，而该部分存货前期已计提存货跌价准备，导致存货跌价准备余额下降；2）由于快充协议芯片的销售快速增长，快充协议芯片的存货结存比例大幅增加，快充协议芯片各期末存货跌价准备计提比例分别为0.50%、15.31%、7.08%和3.72%，对比电源管理芯片各期末存货跌价准备计提比例分别为15.40%、12.04%、14.04%和11.52%而计提比例相对较低，原因系快充协议芯片各期末存货余额相对较低且周转速度整体较快。因公司芯片产品的生命周期一般为2-5年，故公司对库龄超过2年的原材料晶圆和库龄超过1年的半成品及成品芯片已全额计提存货跌价准备，整体计提比例较高，各期末存货跌价准备计提充分。

## （2）2021年6月末核销的存货情况及原因。

2021年1-6月公司核销的存货明细按产品类型列示具体如下：

单位：万元

存货类型	应用领域	1年以内	1-2年	2年以上
原材料	电源管理芯片		15.77	17.47
	快充协议芯片	-	-	-
半成品	电源管理芯片	19.55	71.71	111.08
	快充协议芯片	0.01	0.40	0.79
产成品	电源管理芯片	3.26	50.98	140.27
	快充协议芯片	1.55	25.55	28.66
合计		24.37	164.41	298.27

报告期内，公司结合产品的迭代周期、未来销售预期、是否存在负毛利、存货库龄情况等因素充分计提了存货跌价准备，若确认存货已无使用价值、无法实现销售时则会直接进行报废核销处理；若已出现存货减值迹象，但未来仍有销售的可能，则该存货会予以保留，同时财务上相应计提存货跌价准备。

2021年1-6月公司核销的存货主要是库龄超过1年的半成品和产成品芯片；因上述核销的存货已无使用价值、无法实现销售且已全额计提了存货跌价准备，为节省运营成本，故在本期进行了报废核销处理。

### **申报会计师核查事项**

#### **(1) 核查程序**

1、访谈公司销售负责人，了解公司产品支持二次烧录功能的具体应用类型及相关原因、产品的迭代周期及其影响因素等；

2、获取报告期各期末存货明细表、各期核销的存货明细等，结合产品迭代周期、存货库龄结构情况等分析检查存货跌价准备计提是否充分；了解2021年1-6月核销的存货具体情况及原因。

#### **(2) 核查结论**

经核查，申报会计师认为：

1、截止目前发行人存货中包含部分可能存在升级更新需求且暂不支持二次烧录功能的产品，期末存货余额较小且主要为库龄1年以内的产品，该类存货周转速度较快，整体减值风险较小。报告期各期末，发行人存货跌价准备计提已充分考虑了芯片的迭代周期、存货库龄结构等因素，存货跌价准备计提充分；

2、2021年1-6月核销的存货主要是库龄超过1年的半成品和产成品芯片，因已无使用价值并已全额计提了存货跌价准备，为节省运营成本，在本期进行了报废核销处理。

## **5、关于政府补助**

根据首轮问询回复：公司产品为数模混合 SoC 芯片，因同时集成了软件和硬件，属于嵌入式软件，主营业务收入均为符合增值税即征即退产品当期销售收入；报告期各期可享受增值税退税嵌入式软件部分收入分别为 7,374.08 万元、10,795.66 万元、12,643.37 万元和 11,876.81 万元。

请发行人说明：可享受增值税退税嵌入式软件部分收入的划分依据，与主营业务收入的匹配关系。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

答复：

## 发行人说明事项

可享受增值税退税嵌入式软件部分收入的划分依据，与主营业务收入的匹配关系。

### 一、可享受增值税退税嵌入式软件部分收入的划分依据

报告期内，发行人销售的芯片需同时结合芯片硬件和软件两部分功能才能形成具体应用，软件部分随同芯片硬件一同销售，属于嵌入式软件产品销售。发行人的嵌入式软件主要包含电池电量计算、快充协议通信、无线充电发射协议、TWS耳机通信等软件程序。根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号第二条的规定：

“本通知所称软件产品，是指信息处理程序及相关文档和数据。软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售，构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。”

“第四条之（二）嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算：

#### 1. 嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算方法

即征即退税额=当期嵌入式软件产品增值税应纳税额-当期嵌入式软件产品销售额×3%；

当期嵌入式软件产品增值税应纳税额=当期嵌入式软件产品销项税额-当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额；

当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额×17%；

#### 2. 当期嵌入式软件产品销售额的计算公式

当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额；

计算机硬件、机器设备销售额按照下列顺序确定：

- ①按纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定；
- ②按其他纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定；
- ③按计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。

“计算机硬件、机器设备组成计税价格=计算机硬件、机器设备成本×(1+10%)。”  
 发行人销售的芯片产品符合上述第二条关于嵌入式软件产品的界定。因发行人芯片产品不存在单独销售软件产品或芯片硬件情形，故当期嵌入式软件产品销售额参照上述第四条规定按计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。具体计算公式如下：

可享受增值税退税嵌入式软件部分收入=当期嵌入式软件产品与芯片硬件对外销售额合计-当期芯片硬件成本×(1+10%)。若存在毛利率低于10%的嵌入式软件产品销售，则全部作为芯片硬件销售额，不享受软件产品增值税退税优惠。

同行业集成电路设计公司瑞芯微、中科蓝讯、芯海科技、复旦微电、全志科技等产品销售亦存在享受嵌入式软件产品增值税退税优惠情形。根据中科蓝讯《首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复》（一轮反馈）、芯海科技《首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函之回复报告》（一轮反馈），其关于享受增值税退税嵌入式软件部分收入的计算原理与发行人一致。

二、报告期内，发行人享受的增值税退税嵌入式软件部分收入与主营业务收入相匹配

发行人于2017年2月6日已取得当地主管税务机关国家税务总局深圳市南山区税务局出具的《税务事项通知书(关于增值税即征即退备案通知书)》深国税南 税通(2017)5431号。根据税务部门对享受软件产品增值税优惠的销售管理规定，要求发行人在开具的销售发票上注明相应的软件产品著作权编号并分开列示软、硬件产品收入；报告期内，发行人享受增值税退税嵌入式软件产品销售所开具的发票均按照上述要求执行，发行人在将嵌入式软件产品实际销售给客户并完成发票开具时才确认增值税即征即退税额。报告期内，各期可享受增值税退税嵌入式软件部分收入与主营业务收入的匹配关系如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
当期主营业务收入①	35,190.86	37,475.53	33,768.60	21,491.09
当期享受的增值税退税嵌入式软件部分收入②	11,876.81	12,643.37	10,795.66	7,374.08
嵌入式软件部分收入占主营业务收入比③=②/①	33.75%	33.74%	31.97%	34.31%

报告期内，各期可享受增值税退税嵌入式软件部分收入系根据当期嵌入式软件产品

与芯片硬件对外销售额合计与当期芯片硬件成本组成计税价格计算得出，与主营业务收入变动趋势整体保持一致，占各期主营业务收入的比例分别为 34.31%、31.97%、33.74%和 33.75%，系各期销售的具体芯片产品毛利率结构有所变动所致，整体相匹配。

### **申报会计师核查事项**

#### **(1) 核查程序**

1、访谈发行人财务总监，了解报告期内关于增值税退税嵌入式软件部分收入的划分依据及相关政策文件等；

2、查询同行业集成电路公司是否存在嵌入式软件产品增值税退税情形，享受增值税退税嵌入式软件部分收入划分原理与发行人是否存在差异；

3、获取报告期各期主营业务收入和享受增值税退税嵌入式软件部分收入明细，检查分析是否匹配；获取发行人关于增值税即征即退备案通知书。

#### **(2) 核查结论**

经核查，申报会计师认为：

报告期内，发行人享受的增值税即征即退嵌入式软件部分收入系根据当期嵌入式软件产品与芯片硬件对外销售额合计与当期芯片硬件成本组成计税价格计算得出，与主营业务收入相匹配。

## **7、关于其他**

### **7.1 苏州智集芯**

根据首轮问询回复：苏州智集芯未来将主要在音频智能方面丰富发行人整体的产品业务线，增资入股形成商誉 101.09 万元，2021 年 1-6 月苏州智集芯净利润为-95.49 万元。

请发行人说明：入股苏州智集芯价格的定价依据及公允性，商誉的计算过程，是否存在减值迹象。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

答复：



## 发行人说明事项

### 一、入股苏州智集芯价格的定价依据及公允性

苏州智集芯团队在智能音频处理算法领域具有深厚的行业技术背景，其业务方向为智能音频处理算法的研究，该算法广泛应用于音频放大器、音频编解码器、音频软件方案等领域，与发行人在智能音频处理芯片领域的研究方向较为契合，收购苏州智集芯有利于发行人进一步完善研发团队、形成研发成果、培育新的业务增长点。

苏州智集芯接受发行人入股，主要基于以下原因：一是发行人已形成成熟完整的SoC数模混合芯片研发技术，可与苏州智集芯智能音频处理算法技术相互结合，有利于加快苏州智集芯产品的研发进度，并降低研发失败风险；二是发行人已具备一定的经营规模，并形成了完整的供应链和销售渠道资源，能够帮助苏州智集芯迅速切入到智能手机、智能手表等消费电子客户供应链。

发行人入股苏州智集芯时，苏州智集芯产品处于技术研发阶段。本次交易定价系经各方结合团队成员研发实力、在研项目情况、未来发展预期、集成电路行业现状等因素协商确定，通过出资265万元持有苏州智集芯53%股权，即按投后估值500万元进行增资入股。芯片公司天使轮融资的可比交易案例情况如下：

序号	投资方	融资方	融资方主营业务	融资时间	融资轮次	对应融资方投后估值
1	中新创投、融风投资	敏芯股份(688286.SH)	以MEMS传感器研发与销售为主的半导体芯片设计公司	2008年2月	天使轮	约5,151万元
2	华西投资	上海纵慧光电科技有限公司	半导体光电芯片及模组的开发、生产和销售	2015年12月	天使轮	约12,000万元
3	深创投、南昌红土、红土天使	上海慧新辰实业有限公司	LCOS光调制芯片(光阀芯片)和LCOS光学模组(光机)，本次融资时尚处于研发阶段，研发中的芯片尚未研发成功	2019年11月	天使轮	约20,000万元

注：上述可比交易案例的相关信息来自于敏芯股份(688286.SH)、华西股份(000936.SZ)、\*ST晨鑫(002447.SZ)的公告文件或基于相关披露信息计算得出。

苏州智集芯团队主要成员的任职及技术背景如下：

江超，硕士研究生学历。2005年7月至2006年9月，任西门子(中国)有限公司音频工程师；2006年9月至2018年5月，历任歌尔股份有限公司技术经理、研发副总、

事业部总经理、丹拿 CEO 等职；2020 年 12 月至今，任苏州智集芯总经理。江超为中国声学学会声频工程分会第九届委员会委员、中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、全国电声学标准化技术委员会（SAC/TC23）委员、“中国电子元件行业协会电声分会专家组”专家，曾作为起草人起草过多个声学相关领域的国家标准，在国内外学术期刊上发表过多篇论文，并拥有中国与美国多项发明专利。

宁尚磊，本科学士学历。2005 年 7 月至 2020 年 10 月，任歌尔股份有限公司研发工程师、技术经理、研发部长、品质总监等职；2020 年 12 月至今，任苏州智集芯研发总监。

发行人入股苏州智集芯时，其在研项目情况如下：

序号	项目名称	拟达到的目的	应用领域
1	新一代智能音频 IC	根据喇叭反馈动态调整音频输出	手机、蓝牙音箱等

综上，发行人入股苏州智集芯的定价为各方综合考虑团队成员研发实力、在研项目情况、未来发展预期、集成电路行业现状等因素的基础上协商确定，交易定价公允。

## 二、商誉的计算过程，是否存在减值迹象

2021 年 1 月 5 日，发行人与苏州智集芯股东苏州智集英才企业管理合伙企业（有限合伙）、江超、中科声创（苏州）企业孵化管理有限公司签署增资协议，由发行人向苏州智集芯增资 265.00 万元以持有其 53% 股权，于 2021 年 1 月 21 日实际完成出资并取得苏州智集芯控制权。因本次增资构成非同一控制下企业合并，发行人以 2021 年 2 月 1 日为购买日，将苏州智集芯科技有限公司纳入合并范围。

于购买日，苏州智集芯可辨认资产、负债主要是货币资金和应付职工薪酬，各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值一致，具体项目如下：

单位：万元

项目	购买日公允价值/账面价值
资产①	254.78
其中：货币资金	254.62
负债②	28.11
其中：应付职工薪酬	25.74
净资产③=①-②	226.66
减：少数股东享有权益④（注）	62.75

项目	购买日公允价值/账面价值
发行人取得的净资产⑤=③-④	163.91

注：于购买日计算少数股东权益时已考虑注册资本是否实缴因素的影响。

商誉计算过程如下：

商誉=长期股权投资-取得 53%股权按照购买日享有苏州智集芯可辨认净资产公允价值份额=265.00-163.91=101.09（万元）

截至报告期期末，苏州智集芯正常经营，所处的行业环境、经营状况及未来经营规划未发生变化。2021 年上半年苏州智集芯净利润为负，主要因为其产品目前仍处于研发阶段。目前苏州智集芯上述在研项目已形成包括识别算法、控制算法在内的核心算法并在 PC 端验证通过，下一步将进一步完成振幅保护及热保护算法，并开始芯片设计开发。针对已取得的阶段性研发成果，苏州智集芯已在申请相关发明专利，具体如下：

序号	专利类型	专利名称	专利申请号	申请日	权利状态
1	发明专利	一种微型扬声器	CN202110122874.4	2021/1/29	实质审查

综上所述，发行人入股苏州智集芯形成的商誉，截至报告期期末未出现减值迹象，未计提商誉减值准备。2021 年 1-6 月发行人合并净利润为 3,727.96 万元，即使苏州智集芯未来经营不及预期，导致发行人入股苏州智集芯形成的商誉 101.09 万元需全额计提减值准备，亦不会对发行人的财务状况构成重大影响。

## 申报会计师核查事项

### （1）核查程序

- 1、访谈发行人董事长，了解入股苏州智集芯的原因、入股价格的定价依据、苏州智集芯团队成员背景等；
- 2、取得并核查了发行人入股苏州智集芯签订的增资协议、苏州智集芯工商底档、于购买日苏州智集芯的财务报表等资料；
- 3、访谈苏州智集芯总经理，了解苏州智集芯经营业务、目前的发展状况、未来的发展预期等。

### （2）核查结论

经核查，申报会计师认为：

发行人入股苏州智集芯主要系看重其团队背景，双方在综合考虑创始团队背景、集成电路行业现状、在研项目情况的基础上协商确定入股价格，定价公允。发行人入股苏州智集芯形成的商誉计算过程准确；截至报告期期末，苏州智集芯正常经营，仍处于产品研发阶段并已取得阶段性成果，未出现商誉减值迹象。

## 7.2 定期存款

根据首轮问询回复：（1）未来三年拟新增的研发项目投入金额分别为 4,100 万元、3,800 万元和 6,000 万元，公司在留足研发投入资金后，将暂没有明确资金用途的 1.2 亿元存入三年定期；（2）公司未来三年流动资金需求缺口为 14,379.42 万元。

请发行人说明：未来三年拟新增的研发项目与募投项目之间是否存在关系，在未来三年流动资金需求缺口为 14,379.42 万元的情况下将 1.2 亿元存入三年定期的原因。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

答复：

### 发行人说明事项

未来三年拟新增的研发项目与募投项目之间是否存在关系，在未来三年流动资金需求缺口为 14,379.42 万元的情况下将 1.2 亿元存入三年定期的原因。

#### 一、未来三年拟新增的研发项目与募投项目之间是否存在关系

未来三年拟新增研发项目与募投项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	未来三年拟新增研发项目名称	拟新增项目投入金额	应用领域	应用领域是否与募投相同	与募投项目相比存在的差异
1	2021 年	集成路径控制的快速充电协议 SOURCE 芯片	500	快充充电器	是	该拟新增研发项目是用于驱动传统硅基 MOS，募投项目应用于驱动氮化镓 MOS；两者相比驱动 MOS 材料不同，一个驱动传统半导体材料，一个驱动第三代半导体。
2	2021 年	新一代大功率升降压 DC-DC	1,200	储能	否	该拟新增研发项目主要用于户外储能设备的太阳能充电和电压转换，不属于募投项目应用方向

序号	年度	未来三年拟新增研发项目的名称	拟新增项目投入金额	应用领域	应用领域是否与募投相同	与募投项目相比存在的差异
3	2021年	最大输出 20W 具有 PD(PPS)快充的车载充电芯片	300	车充	是	该拟新增研发项目为 18W PD 老项目升级到 20W PD 带 PPS 的车载充电芯片。募投项目主要将 10W 车载充电器的输入耐压升高到 40V 以上，满足新能源汽车对更高输出电压的需求；两者相比存在功率、输入电压方面显著不同
4	2021年	全集成的无线充发射端芯片	500	无线充电	否	该拟新增研发项目为无线充电发射芯片，集成 NMOS 及驱动，集成无线充电控制协议，实现高性价比无线充电 IC。不属于募投项目应用方向
5	2021年	支持硬件数码管的快充移动电源芯片	800	移动电源	是	该拟新增研发项目主要将现有的 22.5W 快充移动电源项目升级，新增数码管显示功能，功率维持 22.5W 不变；募投项目将快充移动电源，功率提高到 120W；两者相比存在功率以及支持功能方面显著不同
6	2021年	TWS 充电仓芯片 02	800	TWS 充电仓	是	该拟新增研发项目主要将现有的 TWS 充电仓项目升级，新增电池温度检测功能，并进一步降低芯片成本。募投项目升级低压快充，并将待机电流降低到 3uA，工艺节点从 180nm 升级到 90nm；两者相比在支持功能、充电速度方面显著不同
7	2022年	新一代快充无线充移动电源 SoC	800	无线充移动电源	否	该拟新增研发项目主要将现有的 22.5W 快充移动电源项目升级，新增 15W 无线充发射功能，有线充电功率维持 22.5W 不变；募投项目快充移动电源，功率提高到 120W
8	2022年	多核处理器 PMIC 芯片	1,000	物联网电源管理	否	该拟新增研发项目针对物联网多核处理器的电源管理芯片；不属于募投项目应用方向
9	2022年	汽车前装车充芯片	2,000	车规级电源管理	否	该拟新增研发使用车规级的晶圆、封装、测试技术，来满足车规的高可靠性要求，达到 AEC-Q100 车规认证标准；不属于募投项目应用方向
10	2023年	内置高速数据传输功能的 PD	2,500	高速接口芯片	否	该拟新增研发项目主要是开发用于笔记本上的 typec 口的 PD 充电和高速数据传输 IC；而募投项目的快充协议 IC，不具备高速数据传输功能，不属于募投项目应用方向
11	2023年	多节高精度 BMS 芯片	1,500	锂电保护	否	该拟新增研发项目针对可充电电池的过压保护，集成了电池安全运行需要的一整套检测和保护。可以自行设定保护阈值和延迟，且具有多种配置可以使用，支持最多 14 节电池保护。不属于募投项目应用方向
12	2023年	全集成马达驱动算法控制 SoC	2,000	马达驱动	否	该拟新增研发项目主要是开发针对马达驱动的 SOC 控制芯片，不属于募投项目应用方向

根据上表所述，公司未来三年拟新增 12 个研发项目按照与募投项目的关系可以分为两类：

1、应用领域不同。公司未来三年拟新增研发项目有 8 个与募投项目在产品应用领域不同，主要系储能应用、锂电保护、马达驱动、无线充电、车规级芯片等应用领域，而募投项目应用领域为电源管理芯片和快充芯片；2、应用领域虽然相同但在支持功能、功率、电压等方面存在显著不同。公司未来三年拟新增研发项目中 4 个项目与募投项目在产品应用领域方面相同，但与募投项目相比，在半导体材料、功率值、输入电压、支持的特殊功能以及充电速度等方面存在较大差异。

综上所述，公司未来三年拟新增研发项目与募投项目不存在关系。

**二、在未来三年流动资金需求缺口为14,379.42万元的情况下将1.2亿元存入三年定期的原因**

**(一) 14,379.42 万元流动资金需求缺口计算方法**

公司未来三年存在 14,379.42 万元流动资金需求缺口，主要系假设公司现有主营业务（电源管理芯片+快充协议芯片）、经营模式及各项指标保持稳定，不发生较大变化；营业收入按照固定的速度增长来计算的流动资金需求缺口；即从现有业务出发，给予一定的增长预期，从而得出未来一定区间内对流动资金的需求缺口。根据预测，发行人现有业务在 2020-2022 年期间复合增长率维持 30%前提下，在该区间内对应的流动资金缺口约为 14,379.42 万元。

**(二) 1.2 亿元定期存款为专款专用性质**

截至2020年8月末，公司账面资金约为2.7亿元，主要由8月份收到的2.2亿元投资款构成。具体如下：

单位：万元

日期	投资人	投资额
2020年8月	上海惟牵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,000
2020年8月	上海恒佐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,000
2020年8月	上海科技创业投资有限公司	4,900
2020年8月	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000

2020年8月	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	1,000
2020年8月	东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000
2020年8月	宁波清控汇清智德股权投资中心(有限合伙)	1,500
2020年8月	南京智兆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000
2020年8月	湖南清科小池股权投资合伙企业（有限合伙）托管专户	1,000
2020年8月	共青城展想股权投资合伙企业(有限合伙)托管专户	4,600
<b>合计</b>		<b>22,000</b>

根据2020年8月份公司引入投资人的募集资金使用规划，发行人与投资人约定：投资人投入的2.2亿元将全部用于未来三年拟新增研发项目的建设以及产业化落地，不足部分由公司自有资金补齐。其中，根据意向约定，公司拟投入资金约1亿元（后实际追加到1.39亿元，缺口部分公司以自有资金补足），用于满足未来三年拟新增研发项目的研发资金需求。未来三年拟新增研发项目将在公司目前消费电子为主要下游应用领域的基础上，逐步拓展包括汽车电子、家用电器/工业控制、物联网、储能等其他细分领域，因此与公司现有业务存在不同。同时考虑到研发项目一般会在研发启动后2年左右进行流片并根据流片情况推进产业化落地进度，在整个研发以及产业化落地过程中，需要营运资金提供支持，因此，公司将融资2.2亿元中除去新业务方向所需的研发资金1亿元后，剩余1.2亿元存入三年定期，作为流动资金支持未来三年拟新增研发项目的顺利实施。

综上分析，公司未来三年存在14,379.42万元流动资金需求缺口是基于公司现有业务经营情况以及未来增长预期计算的缺口，并未考虑未来三年拟新增的研发项目所需流动资金；而1.2亿元定期存款则是在发行人与投资人关于投入资金用途达成一致的前提下，为未来三年拟新建的研发项目所涉及的新业务方向提供保障的流动资金，二者不存在冲突，具有合理性。

### **申报会计师核查事项**

#### **(1) 核查程序**

1、访谈公司总经理及财务部门负责人，了解公司该笔定期存款的形成背景及合理性；

2、获取该单位定期存款产品协议书，了解具体产品信息及产品约定等情况；

3、获取该单位定期存款开户证实书，核实存入金额、计息利率以及存款期限等；根据开户证实书，发行人将 1.2 亿元分四笔存入华润银行，凭证号码分别为 09091061、09091030、09091033 以及 09091031；

4、登陆企业网上银行，通过账号查询到，发行人共有 4 笔单位定期存款，合计金额 1.2 亿元；

5、就该单位定期存款向银行进行发函确认，根据珠海华润银行回函，公司定期存款户存在四笔余额为 3,000 万元的定期存款，函证核实相符。

## **(2) 核查结论**

经核查，申报会计师认为：

- 1、根据核查，该笔 1.2 亿元单位定期存款具有真实性。
- 2、公司未来三年拟新增研发项目与募投项目不存在关系。

3、公司未来三年存在 14,379.42 万元流动资金需求缺口是基于公司经营情况以及未来增长预期计算的缺口，并未考虑未来三年拟新增的研发项目所需流动资金；而 1.2 亿元定期存款则是为未来三年拟新建的研发项目所涉及的新业务方向提供保障的流动资金，二者不存在冲突，具有合理性。

(以下无正文)



(此页无正文, 为深圳英集芯科技股份有限公司容诚专字[2021]518Z0510号专项  
核查意见签章页)

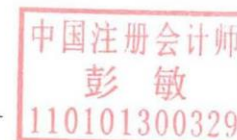


中国·北京

中国注册会计师:  
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年9月16日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.